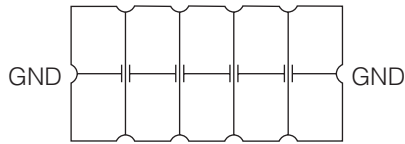


## 阵列片式 3端子电容器

### EZASC型

### EZANC型



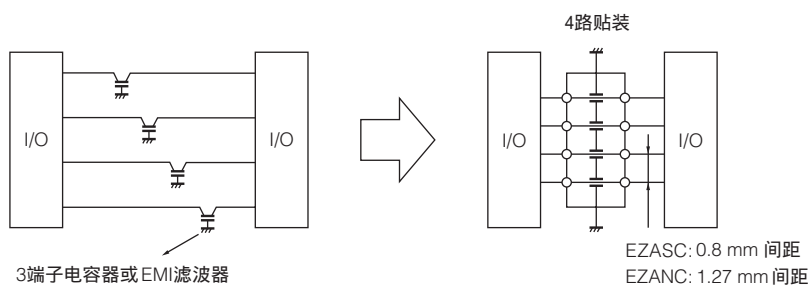
(内置4元件)



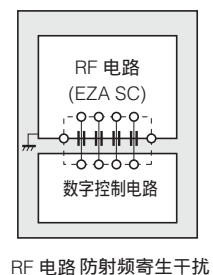
### ■ 特点

1. 适用于消除高频噪声
  - 高频区域残留电感微小，噪声消除效果卓越
  - 优良的接地设计，实现与EMI滤波器（复合型）几乎同等的噪声消除效果
2. 小巧、高度低、牢固、利于高密度贴装
  - EZASC : 4.0 mm × 2.1 mm × 0.65 mm，端子间距 0.8 mm
  - EZANC : 6.4 mm × 3.1 mm × 0.75 mm，端子间距 1.27 mm
  - 标准形状，也可用于高速自动贴装
3. 本公司开发的凹电极结构，充分发挥表面贴装优势
  - 焊接牢固度高（凸电极比：约2倍）
  - 自对准功能，自动修正安装偏差
  - 已应对 RoHS指令

### < 高密度贴装效果 >



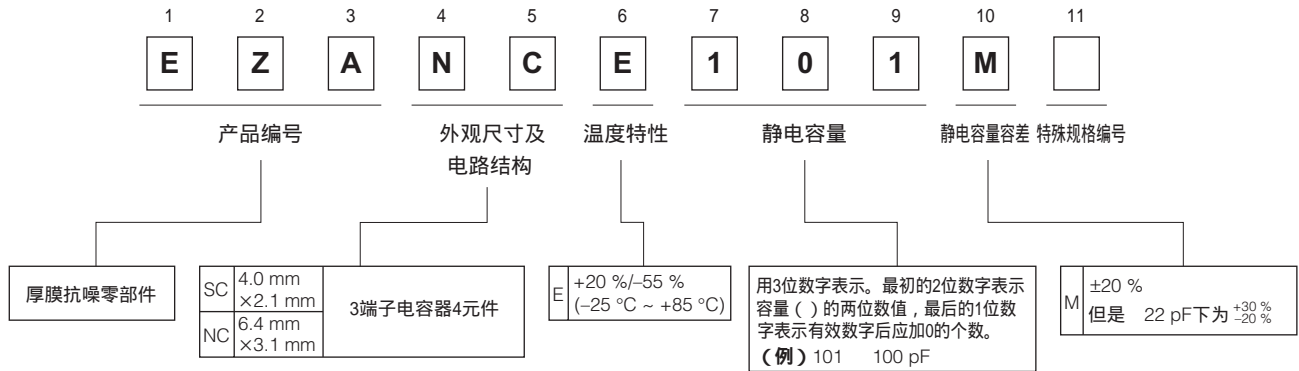
### 《数码移动电话》



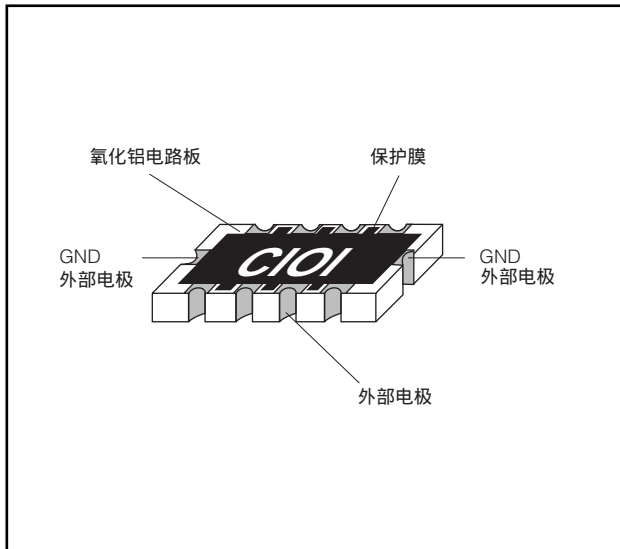
### ■ 主要用途

- 用于电脑、电脑用 MCIA卡、PDA、打印机、HDD，文字处理机的数字高频降噪
- 用于数码移动电话、“小灵通”、GSM、DECT 等防射频寄生干扰措施
- 用于数码视频、数码电视机、CD，MD，DAT 等数码音像设备
- 用于电子乐器，计测器，数码设备

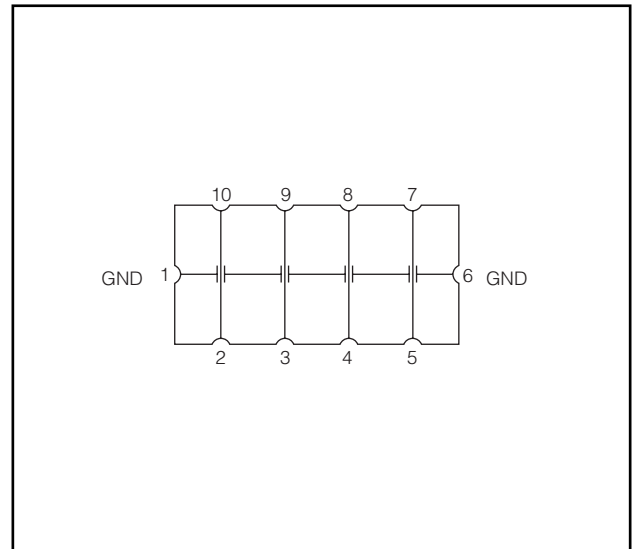
## ■ 型号命名方式



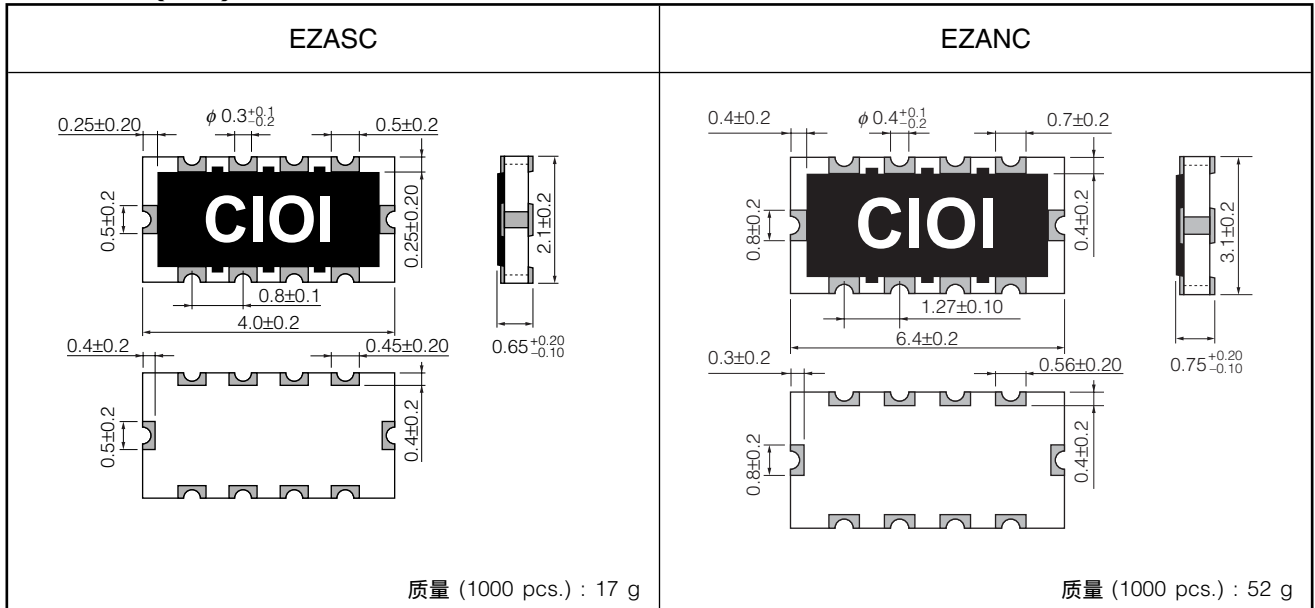
## ■ 结构图



## ■ 电路结构



## ■ 外观尺寸 (mm)



## 规格

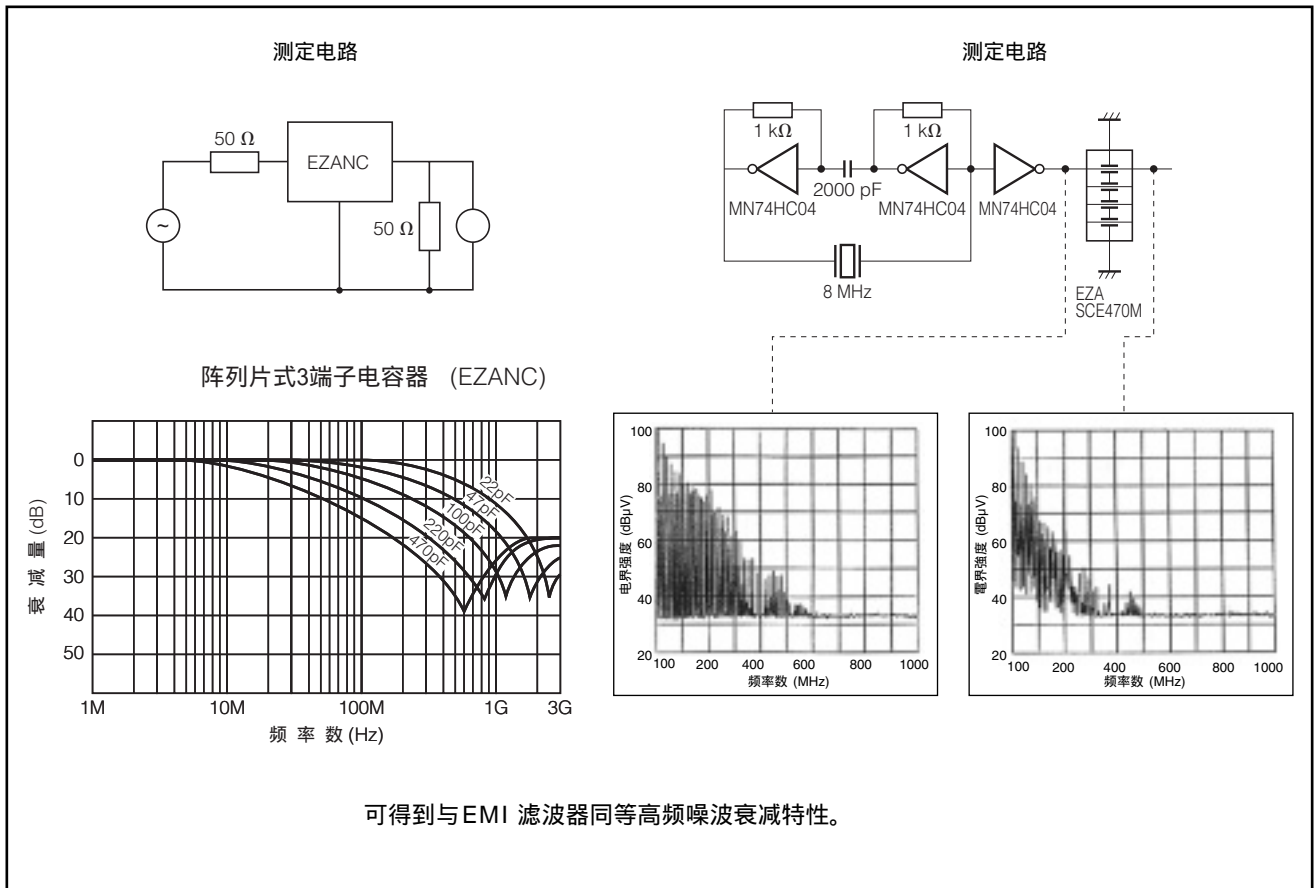
项目	规格	
	EZASC	EZANC
静电容量 (25 °C, 1 kHz <sup>(1)</sup> , 1 Vrms)	10 pF ~ 180 pF 标准: 22 pF, 47 pF, 100 pF	22 pF, 47 pF, 100 pF, 220 pF, 470 pF
静电容量容差	-20 % (22 pF下为 <sup>+30%</sup> / <sub>-20%</sub> )	
静电容量温度特性	E特性: +20 %/-55 % (-25 °C ~ +85 °C)	
介质损耗因数	2 %以下 (25 °C, 1 kHz <sup>(1)</sup> , 1 Vrms)	
额定电压	25 V	
额定电流 <sup>(2)</sup>	200 mA	300 mA
直流电阻 <sup>(3)</sup>	1 Ω以下	
类别温度范围 (使用温度范围)	-25 °C ~ +85 °	

(1) 根据高介电常数电容器规定在1 kHz下测定。在1 MHz测定情况下, 静电容量和介质损耗因数均不同。

(2) 3端子电容器输入端子和输出端子间的通电额定电流。

(3) 3端子电容器输入端子和输出端子间的直流电阻。

## 衰减特性

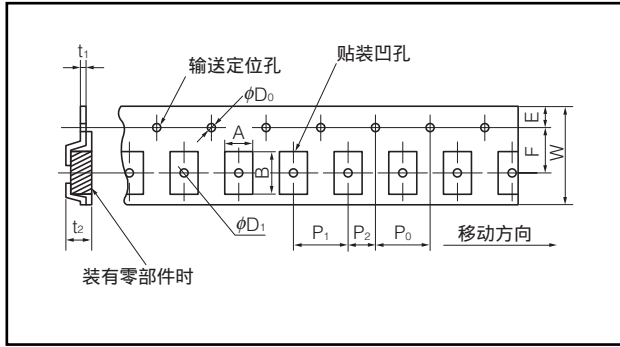


## 包装方法 (带状包装)

### 标准数量

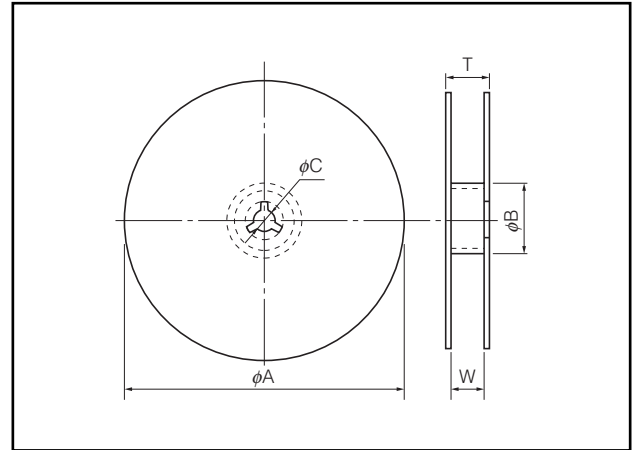
型号	带状包装种类	间距 (P1)	数量
EZASC	模压载带包装	4 mm	4000 pcs. 个/卷盘
EZANC			

### ● 模压载带包装



	型号	A	B	W	F	E	P <sub>0</sub>
尺寸 (mm)	EZASC	2.50 <sup>±0.20</sup>	4.40 <sup>±0.20</sup>	12.00 <sup>±0.30</sup>	5.50 <sup>±0.20</sup>	1.75 <sup>±0.20</sup>	4.00 <sup>±0.10</sup>
	EZANC	3.50 <sup>±0.20</sup>	6.80 <sup>±0.20</sup>				
	型号	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	φD <sub>0</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>
尺寸 (mm)	EZASC	4.00 <sup>±0.10</sup>	2.00 <sup>±0.05</sup>	1.50 <sup>+0.10</sup> <sub>-0</sub>	0.25 <sup>±0.05</sup>	1.15 <sup>±0.20</sup>	1.50 <sup>+0.10</sup> <sub>-0</sub>
	EZANC					1.30 <sup>±0.20</sup>	

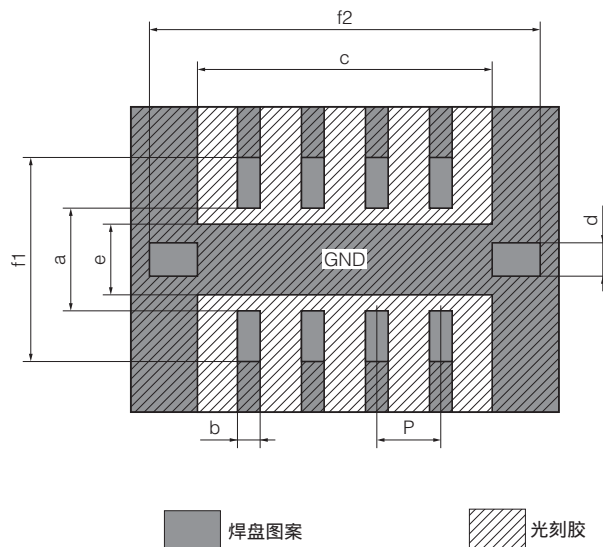
### ● 带状包装用卷盘



尺寸 (mm)	φA	φB	φC
	180.0 <sup>+0</sup> <sub>-3.0</sub>	60 min.	13.0 <sup>±1.0</sup>
尺寸 (mm)	W		T
	13.0 <sup>±1.0</sup>		15.4 <sup>±2.0</sup>

### ■ 焊盘图案设计

阵列片式 3 端子电容器 (EZANC/EZASC)



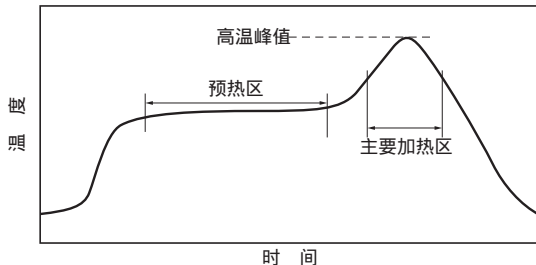
	型号	a	b	c	d	e	f1	f2	P
尺寸 (mm)	EZASC	1.2 ~ 1.4	0.4	3.1 ~ 3.3	0.4 ~ 0.5	0.8	2.9 ~ 3.3	4.8 ~ 5.2	0.8
	EZANC	2.2 ~ 2.4	0.4 ~ 0.6	5.7 ~ 5.9	0.4 ~ 0.8	1.8	4.2 ~ 4.6	7.5 ~ 7.9	1.27

## ■ 推荐焊接条件

本产品推荐焊接条件及注意事项如下所示。

### ● 回流焊推荐条件

- 最多使用2次回流焊。
- 超出正常温度时，请务必与本公司确认。
- 根据电路板及焊锡的种类，请事先确认产品端子部温度以及焊接特性。



### ● 浸流焊

由于EZASC型端子间距仅0.8 mm，端子间极易发生电桥串扰，因此不推荐使用浸流焊。  
有关EZANC浸流焊详细事宜，请咨询本公司。

### 共晶焊锡 (Sn/Pb 系列等)

	温度条件	时间
预热区	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
主要加热区	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
高温峰值	235 ± 5 °C	10 秒以内

### 无铅焊锡 (Sn/Ag/Cu 系列等)

	温度条件	时间
预热区	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
主要加热区	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
高温峰值	max. 260 °C	10 秒以内

## ⚠ 安全注意事项

请务必仔细阅读并确认以下安全注意事项，以及本产品介绍中第 EX2 页上已注明 EMI 对策零部件，保险丝，传感器（MR 元件）的通用注意事项之相关内容。

### 1. 零部件安装

注意贴装过程中及贴装后请勿对零部件施加机械性压力，以避免本品电极及保护膜产生破损。

注意避免贴装过程中产生的位置偏差，可能造成焊锡桥接不良。

2. 请勿使用卤素助焊剂，其残留熔剂可能会影响本产品的性能及可靠性。
3. 用焊铁进行焊接作业时，请勿使焊铁头直接接触电阻。另外，在焊铁头高温情况下尽量缩短焊接作业时间。（350 以下、3 秒以内）
4. 焊料使用量越多，本产品遭受机械性压力的可能越大，并会引发表面裂纹等品质问题。因此在焊接作业时应尽量减少焊料使用量。
5. 请勿撞击，或用硬物（钳子，镊子）夹取本产品，以免使本产品的保护膜及本体造成伤害，进而使本产品产生缺陷影响其使用性能。
6. 避免由于印制电路板过度弯曲而对本产品造成碰撞挤压。
7. 由于高介电常数电介质材料的固有特性，可能造成静电容量值比出厂值降低几个百分点，敬请注意。

## △ 安全注意事项 ( EMI 对策零部件, ESD 零部件, 保险丝, MR 传感器的通用注意事项 )

- 使用本产品时, 无论其用途如何, 请务必事先交换所采购产品的规格书。本产品介绍中的设计及规格在发生变更时可能不予事先通知, 敬请谅解。
- 在本目录内容缺失情况下请勿使用本产品。
- 本产品介绍所示内容为具体产品的品质及性能。用户在本产品贴装后, 务必对整体产品进行测试评估。
- 当本产品应用于运输设备 ( 火车、汽车、船舶等 )、通信设备、医疗设备、航天设备、电热用品、燃油燃气设备、旋转设备、防灾·防盗设备上, 并因本产品出现的故障问题而可能导致人身伤害及其他重大伤害时, 请务必设计下列故障保护系统, 以确保设备的安全运转。
- \* 设置保护电路及保护装置的系统
- \* 设置冗余电路, 出现单一故障时可确保安全的系统

### 1) 使用注意事项

- 本产品的的设计、制造广泛适用于普通用途的电子设备 ( 音像设备、家电产品、办公设备、信息·通信设备等 )。
- 本产品设计时未考虑在下述特殊环境中的使用情况, 请务必预先对质量、性能的影响做充分调查确认后判断是否可以使用。
  1. 水、油、药液、有机溶剂等液体中
  2. 直射阳光、室外暴晒、尘埃中
  3. 海风,  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$  等腐蚀性气体较多的场所
  4. 易产生静电的环境 ( ESD 保护产品除外 )
    - 小型元件对静电放电 ( ESD ) 敏感。
    - 因静电放电 ( ESD ) 受到损伤。
    - 请采取静电放电 ( ESD ) 保护措施。
  5. 电磁波环境
    - 请避免在强电磁波环境下使用本产品。
  6. 结露环境
  7. 用树脂等对本产品或装有本产品的印制电路板进行密封、涂层。
- 本产品通电后会产生焦耳热。为避免对其他元件造成不良影响, 请务必注意元件装配位置。 ( 温度保险丝除外 )
- 由于周边部件产生的热量可能使本产品超过工作温度, 为避免因周边的发热元件导致本产品超过工作温度, 请务必注意元件装配位置。。另外, 请勿将本产品安装于发热部件及塑料配线等可燃物附近。 ( 温度保险丝除外 )
- 使用免清洗焊料进行焊接作业, 以及使用卤素助焊剂及水溶性助焊剂会对本产品性能及可靠性造成不良影响, 请务必注意。
- 由于焊接后的助焊清洗剂可能会对本产品性能及可靠性造成不良影响, 请务必慎重选择清洗剂。尤其在使用水及水溶性清洗剂时, 须考虑到水渍残留对绝缘性的影响。

### 2) 保管注意事项

可焊性等性能质保期: 在一定温度 (  $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$  ) , 湿度 (  $45\% \sim 85\% \text{RH}$  ) 的环境下, 自本产品以完整包装到达用户处起 1 年内。

但是, EMI 滤波产品的质保期为在一定温度 (  $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$  ) , 湿度 (  $40\% \sim 60\% \text{RH}$  ) 的环境下, 从交货日起 6 个月及 1 年两种, 请务必事先确认。温度保险丝的质保期为在一定温度 (  $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$  ) , 湿度 (  $30\% \sim 75\% \text{RH}$  ) 的环境下, 从交货日起 1 年。

即便如此, 在上述质保期内仍有可能出现由于电气性能以及可焊性的下降、包装材料 ( 编带等 ) 的变形、变质而引起的贴装工艺问题, 请务必避免在下述环境下保管本产品。

1. 海风,  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$  等腐蚀性气体较多的场所
2. 阳光直射的场所

### <包装标识>

包装上标有产品型号、数量、原产地等。  
此外, 原产地原则上用英语表示。